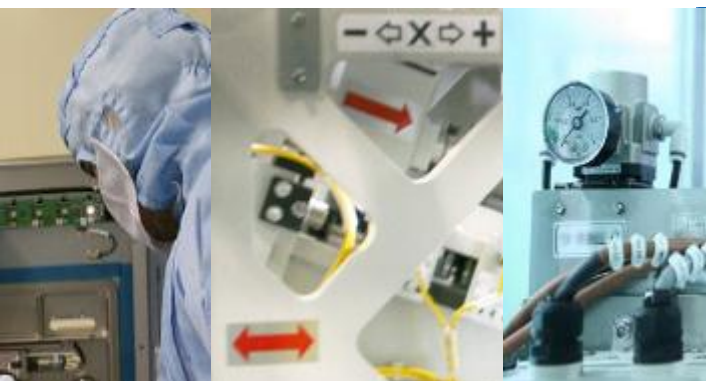


2014年3月期 第1四半期決算説明資料

平田機工株式会社 2013.8.12



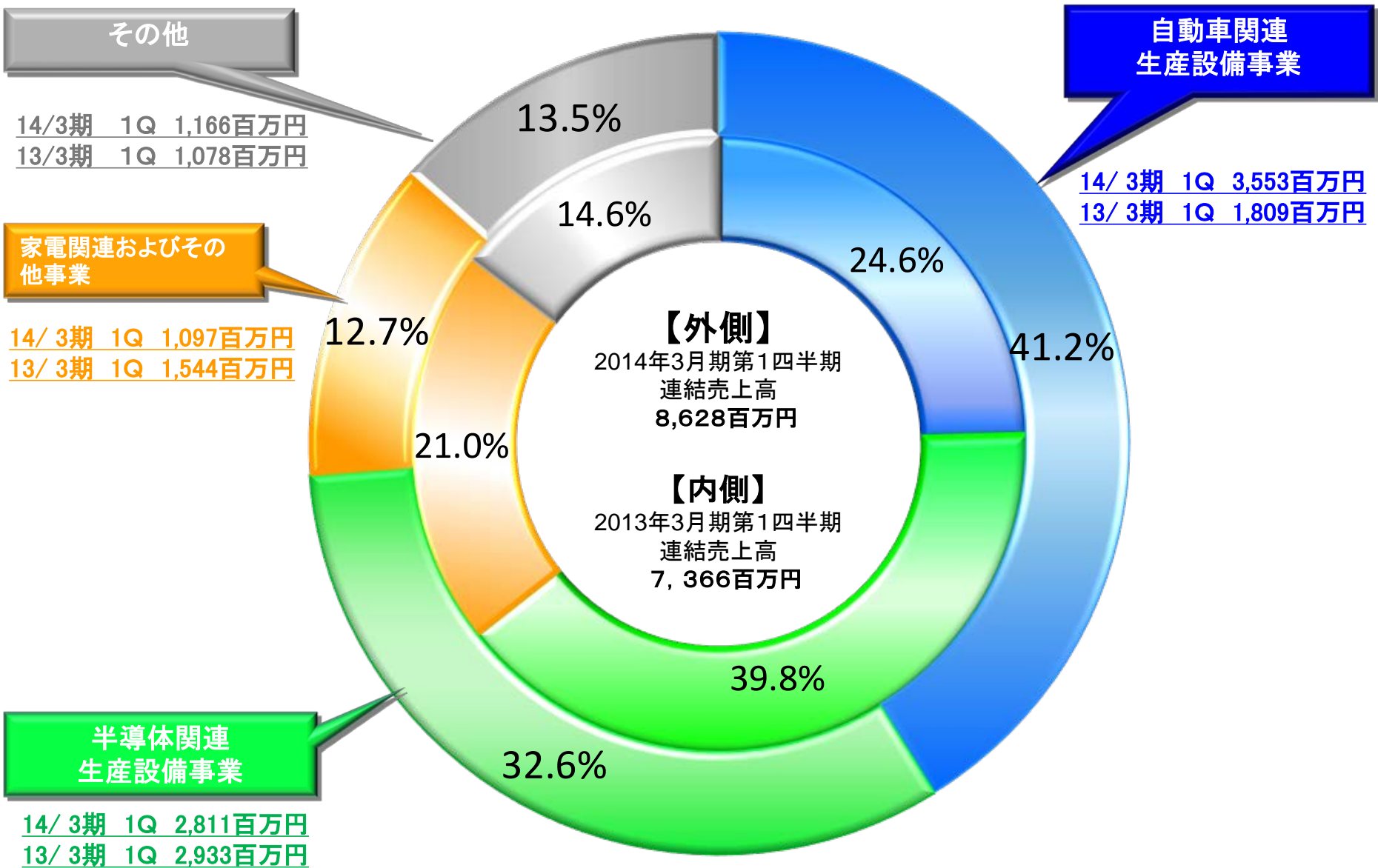
The Global Production Engineering Company
Hirata



I 決算状況

2014年3月期第1四半期（2013年6月30日）

I 決算状況 事業部門別売上高構成比



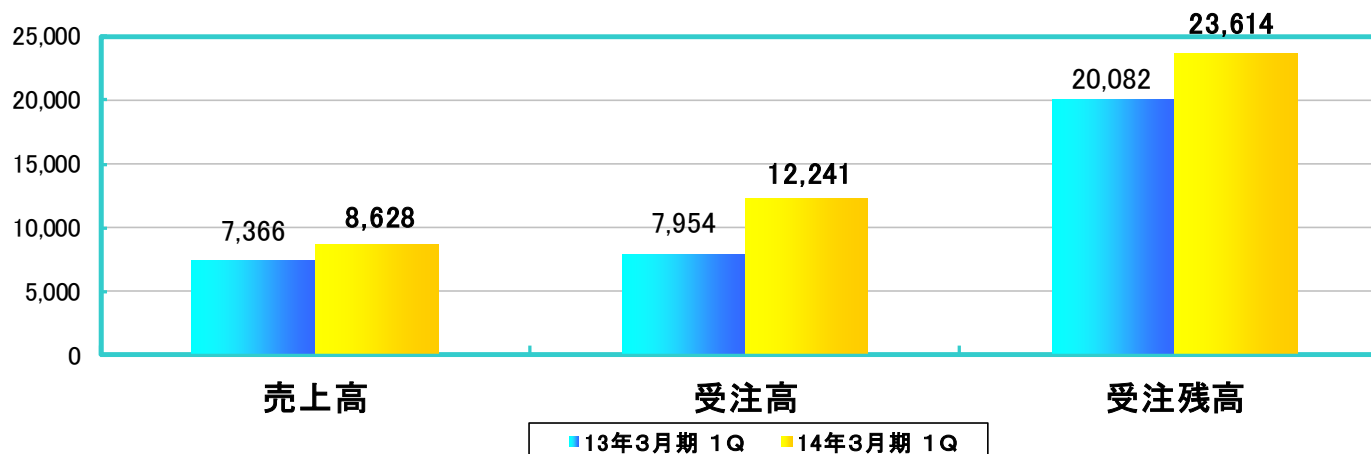
決算概要

- 主に自動車関連の売上増により前年同期比増収。
- 増収及び原価率の改善により、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに増加。
- 自動車関連他、各事業分野共に受注増となり、受注残高も増加。

連結決算

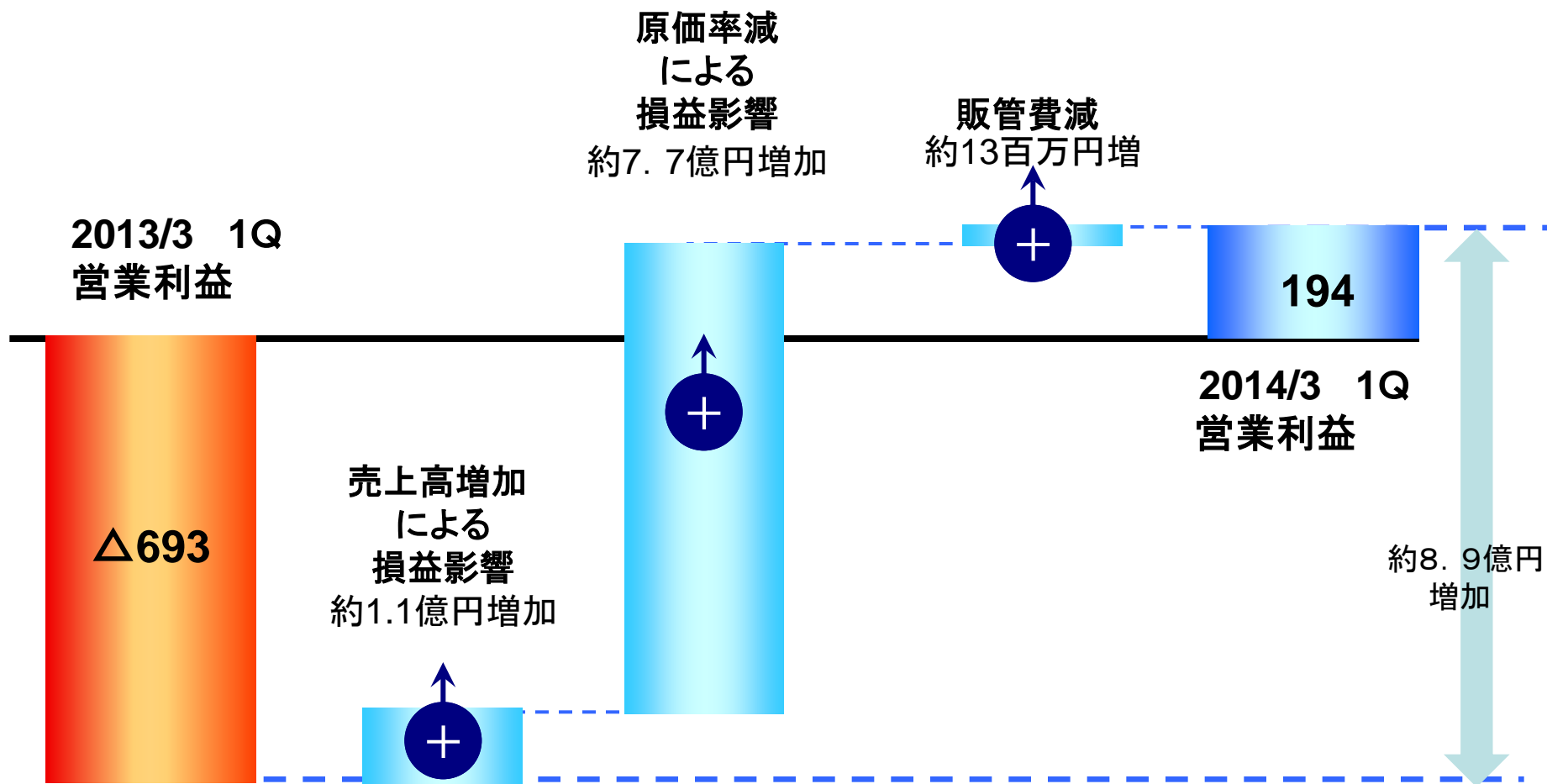
(単位:百万円)

連結決算	2013年3月期 第1四半期 実績	2014年3月期 第1四半期 実績	増減率
売上高	7,366	8,628	+17.1%
営業利益	△693	194	—
経常利益	△695	177	—
四半期純利益	△459	77	—



I 決算状況 営業利益の増減要因分析

(単位:百万円)



I 決算状況 事業部門別連結売上高

■ 半導体関連、家電関連は低調だったが、自動車関連の売上により増収。

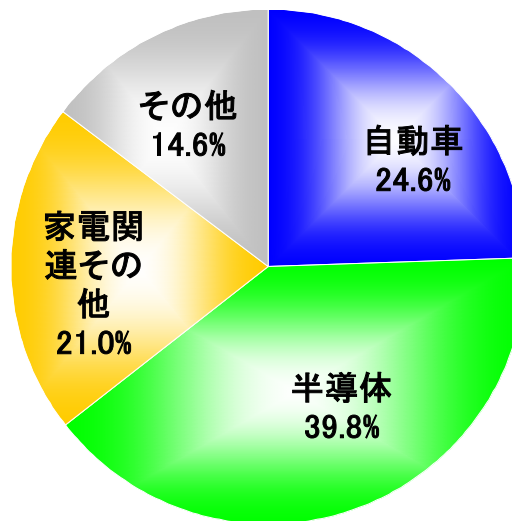
- ・ 自動車関連設備：主に北米・中国メーカー向け設備の売上げにより、前年同期比でほぼ倍増。
- ・ 半導体関連設備：製造受託案件は堅調だったが、その他の売上が低調でやや減収。
- ・ 家電関連およびその他：家電、タイヤ等、全体的に低調となり減収。

事業部門別売上高の状況

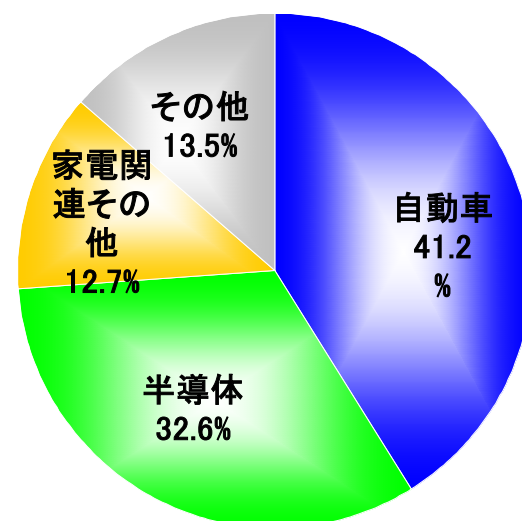
単位：百万円

事業部門	2013/3 1Q	2014/3 1Q	前期比 増減率
自動車	1,809	3,553	+96.4%
半導体	2,933	2,811	△4.2%
家電関連 その他	1,544	1,097	△29.0%
その他	1,078	1,166	+8.1%
合計	7,366	8,628	+17.1%

2013/3 1Q



2014/3 1Q



I 決算状況 事業部門別連結受注高

■ 半導体関連を筆頭に各事業分野とも増加。

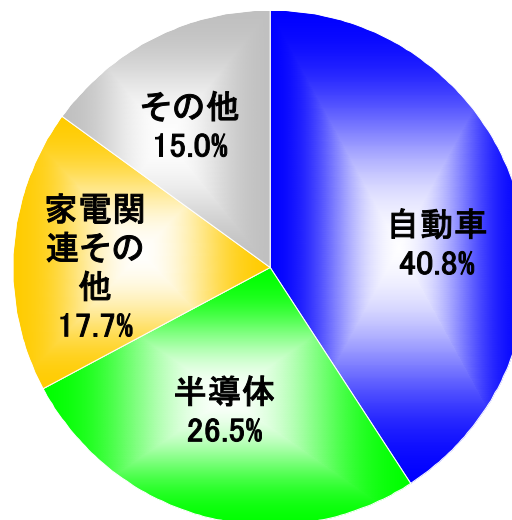
- ・ 自動車関連設備: 北米メーカー、国内部品メーカーからの受注により増加。
- ・ 半導体関連設備: 国内メーカーに加え、北米メーカーからの受注も増え、大幅増。
- ・ 家電関連およびその他: タイヤ関連の他、住宅関連設備など様々な業種からの受注により増加。

事業部門別受注高の状況

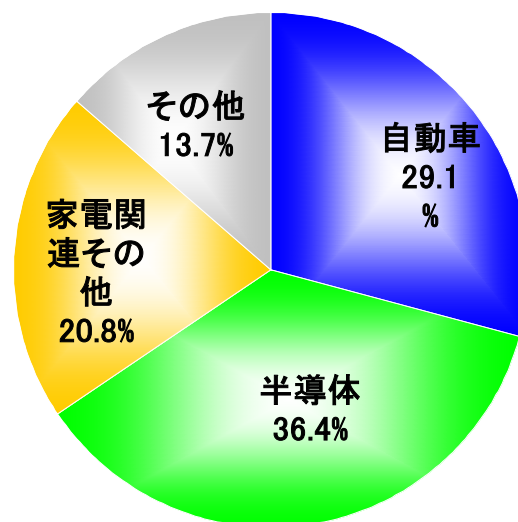
単位:百万円

事業部門	2013/3 1Q	2014/3 1Q	前期比 増減率
自動車	3,249	3,564	+9.7%
半導体	2,104	4,457	+111.8%
家電関連 その他	1,408	2,547	+80.9%
その他	1,192	1,671	+40.2%
合計	7,954	12,241	+53.9%

2013/3 1Q



2014/3 1Q



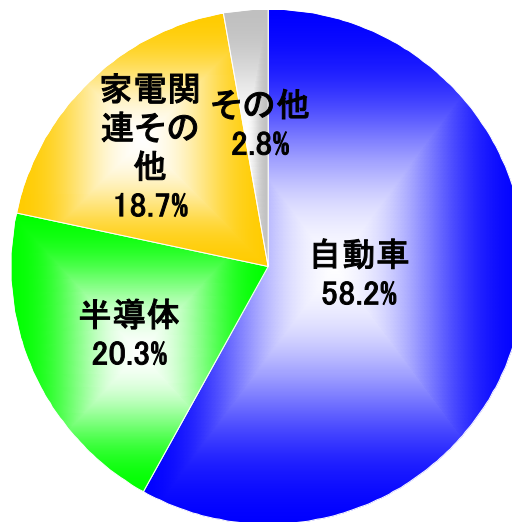
- 自動車関連は北米・中国メーカー向けを中心に増加。他事業分野も、ともに増加。

事業部門別受注残高の状況

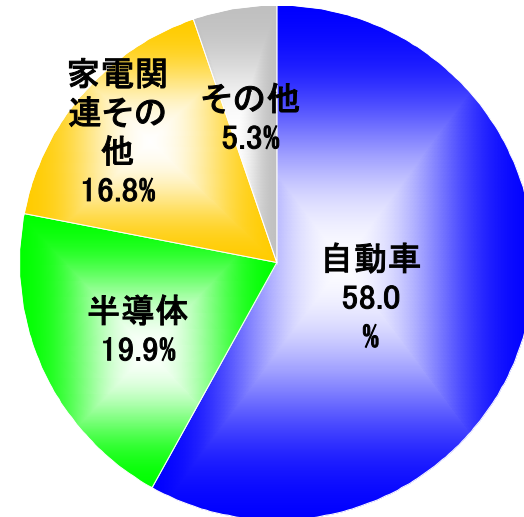
単位：百万円

事業部門	2013/3 1Q	2014/3 1Q	前期比 増減率
自動車	11,685	13,693	+17.2%
半導体	4,068	4,708	+15.7%
家電関連 その他	3,765	3,968	+5.4%
その他	563	1,244	+120.9%
合計	20,082	23,614	+17.6%

2013/3 1Q



2014/3 1Q



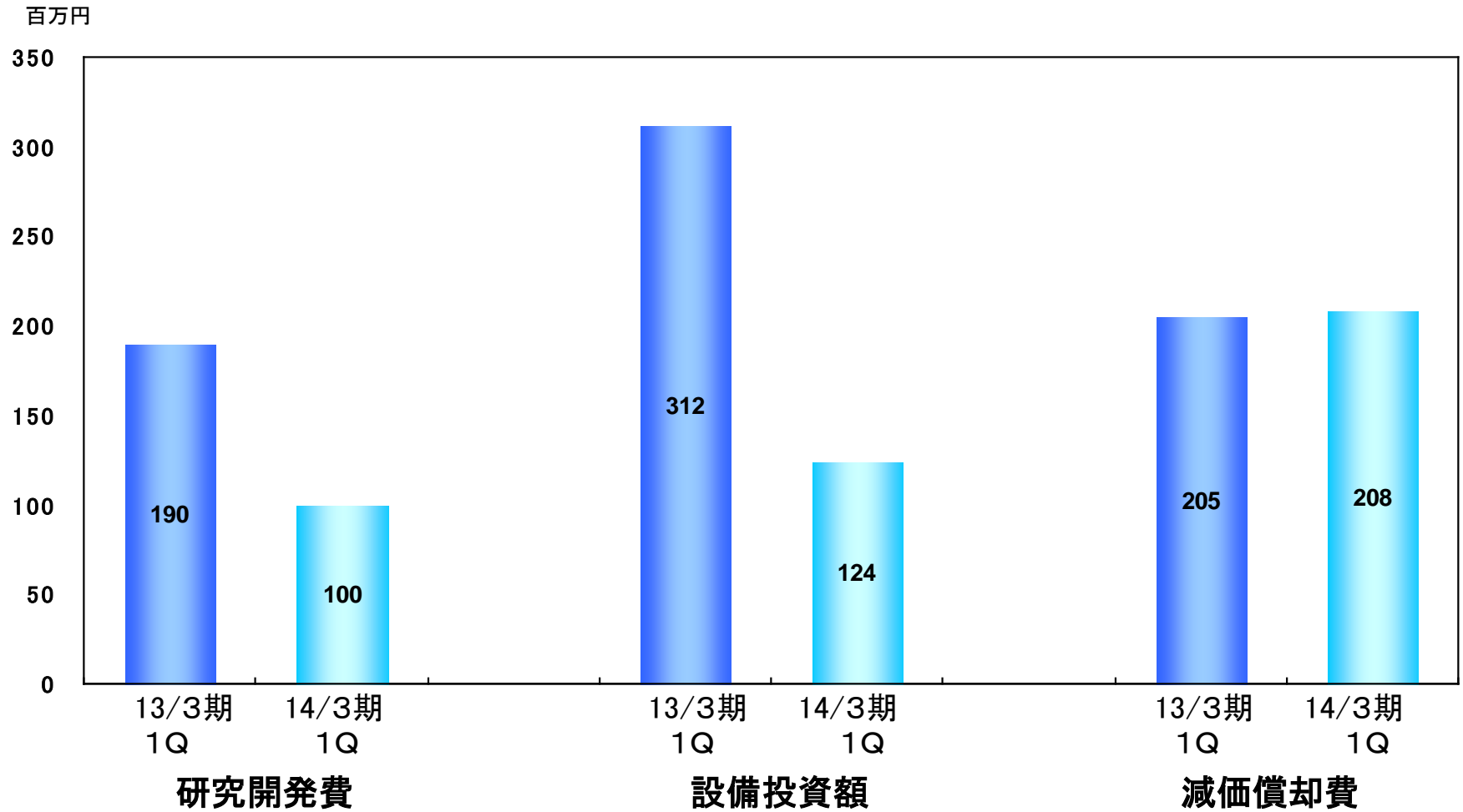
IV 2014年3月期業績の見通し

2014年3月期第1四半期（2013年6月30日）

※業績予想に変更はありません。

(単位:百万円)

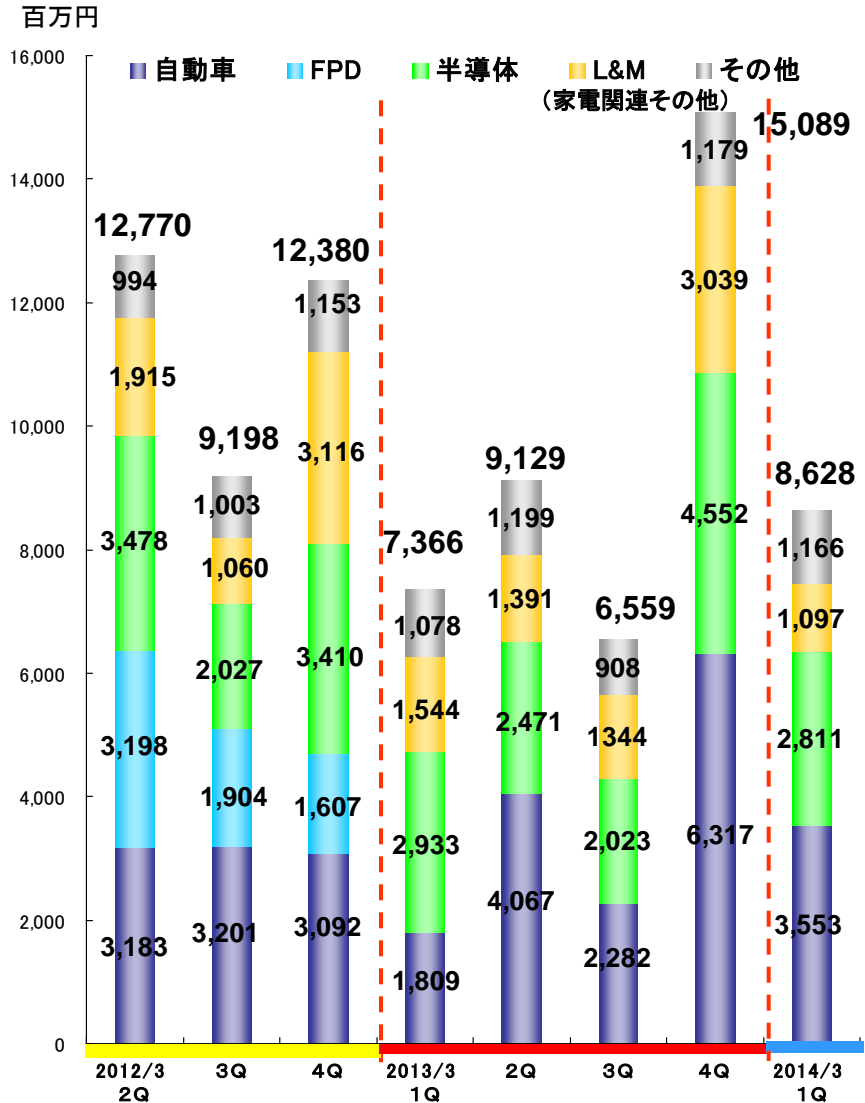
	上期	下期	通期
売上高	22,000	20,000	42,000
自動車関連	9,000	8,500	17,500
半導体関連	5,500	6,000	11,500
家電関連およびその他	5,000	3,000	8,000
その他	2,500	2,500	5,000
営業利益(率)	500 (2.3%)	200 (1.0%)	700 (1.7%)
経常利益(率)	400 (1.8%)	100 (0.5%)	500 (1.2%)
当期純利益(率)	250 (1.1%)	50 (0.3%)	300 (0.7%)



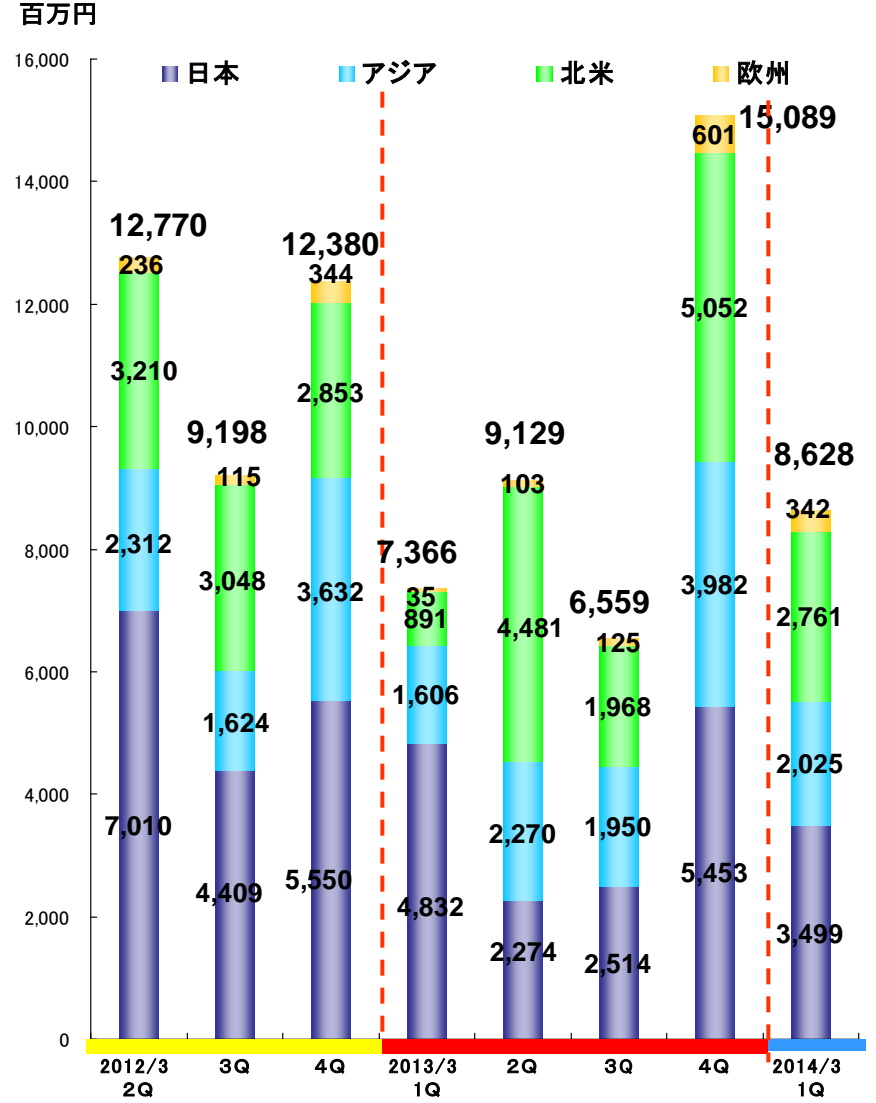
V 参考資料

2014年3月期第1 四半期（2013年6月30日）

事業部門別四半期売上高の推移

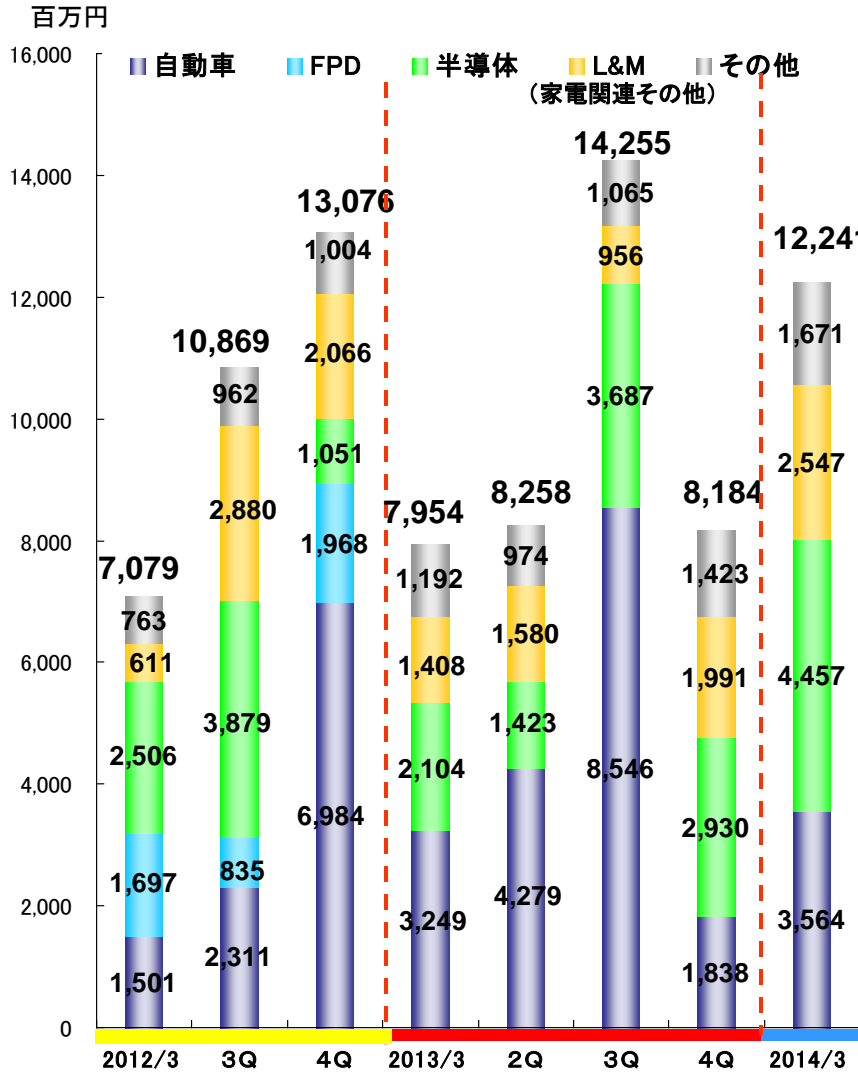


地域別四半期売上高の推移

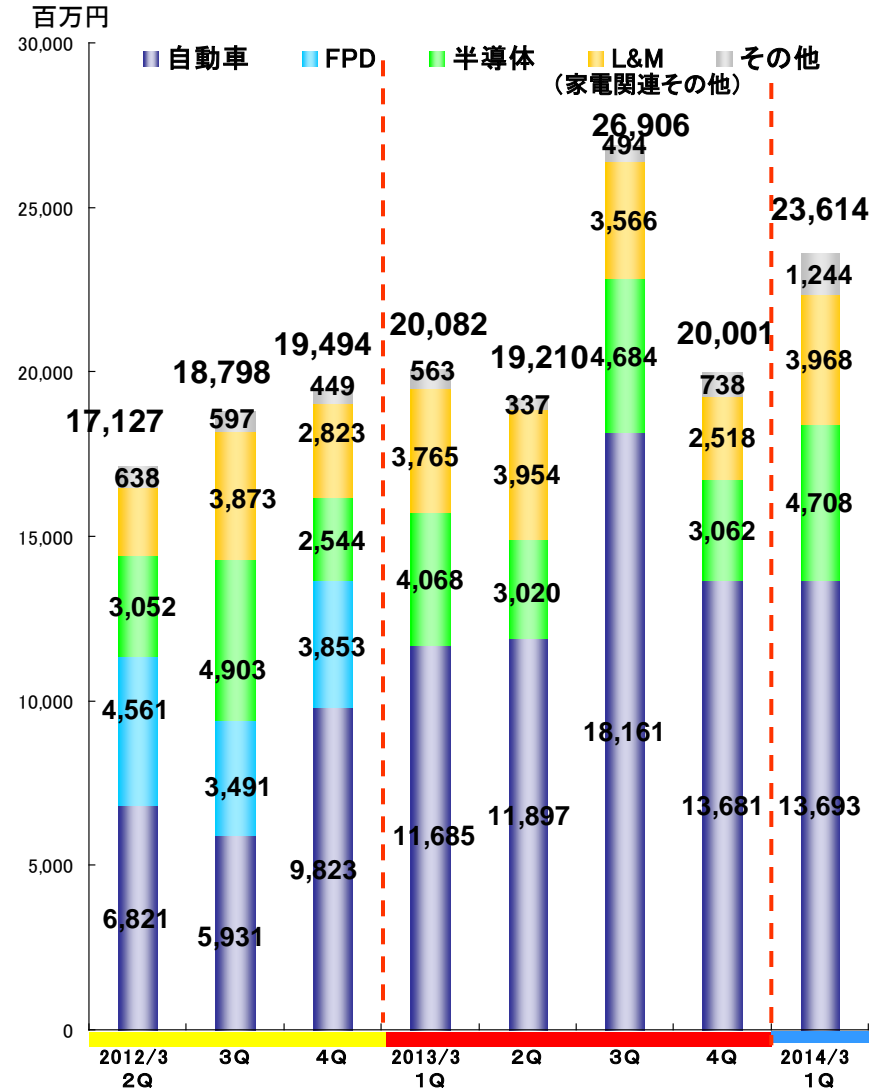


【注】2013年3月期第1四半期より区分を変更し、FPD関連は半導体関連に含めております。また、L&Mは「家電関連その他」に変更しております。

事業部門別四半期受注高の推移



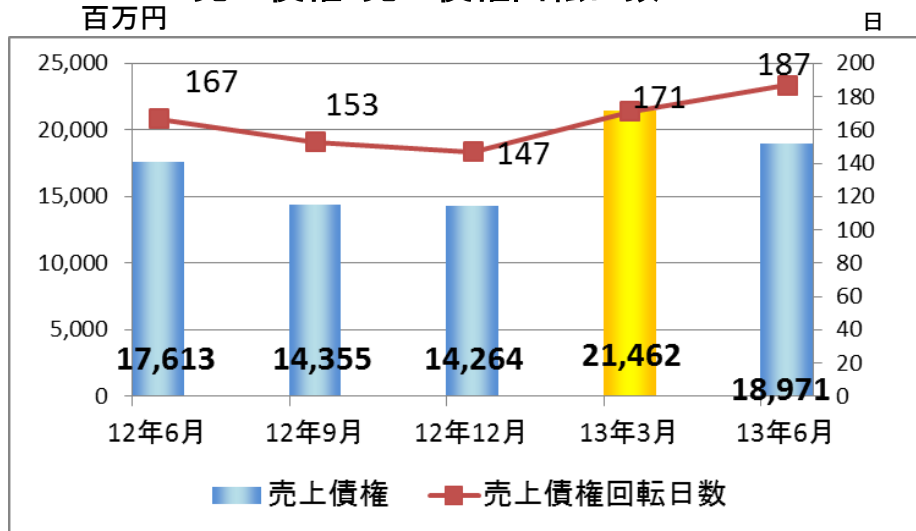
事業部門別四半期受注残高の推移



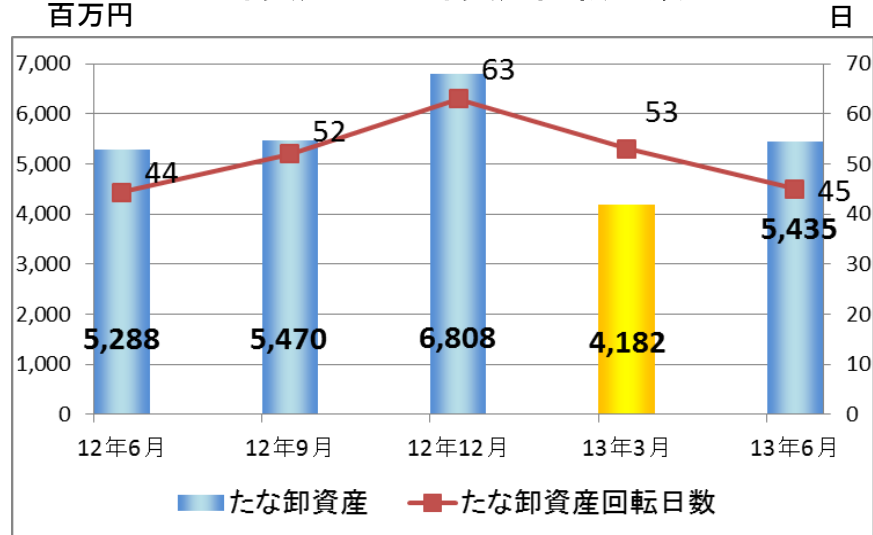
【注】2013年3月期第1四半期より区分を変更し、FPD関連は半導体関連に含めております。また、L&Mは「家電関連その他」に変更しております。

V 参考資料 主要指標

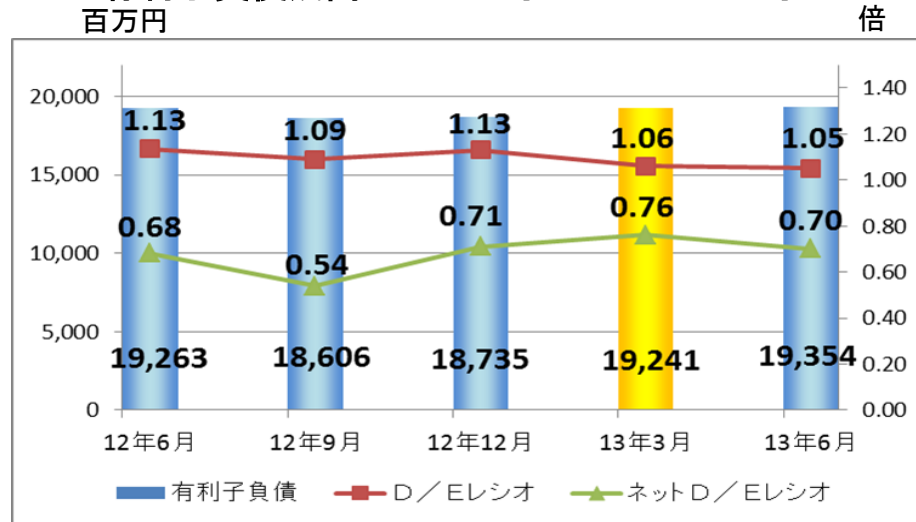
売上債権・売上債権回転日数



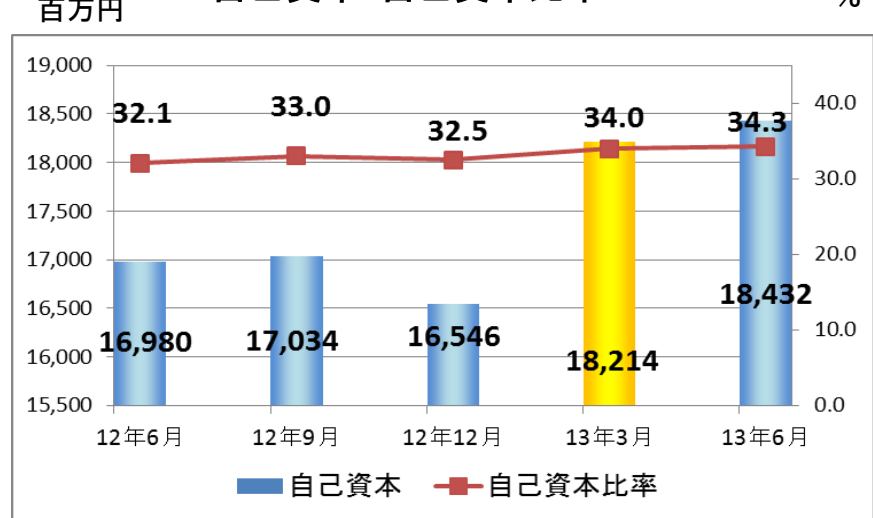
たな卸資産・たな卸資産回転日数



有利子負債残高・D/Eレシオ・Net D/Eレシオ



自己資本・自己資本比率



【注】売上債権回転日数、たな卸資産回転日数については、各四半期毎の期中平均値にて算出しております。

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることあることをご承知おきください。